INNOVATORS INVITE INNOVATORS

부품소재 혁신을 통해 LG이노텍과 함께 세상을 바꾸어나갈 인재를 초대합니다.

모집 대상	석사/박사 학위 이상 보유자 및 취득 예정자 (~25년말)
모집 분야	R&D ▪ 모듈부품 : 광학, Lens, Actuators, 모바일 CM/3D(H/W), Radar, 전력전자, Substrate ▪ 소재소자 : 자성소재/부품, 수동소자/부품 ▪ Software 및 기타 (Simulation, 기구)
지원 방법	LG Careers 지원 (careers.lg.com) ▪ 채용 공고명 : [전사] LG이노텍 해외대학 석박사 신입사원 및 산학장학생 모집
모집 기간	'22년 11월 18일(금) ~ '23년 1월 9일(월), 오전 10:00 (한국시)
전형 절차	실무인터뷰(화상) › 임원인터뷰(대면) › 건강검진 › 최종입사 ① 화상 면접 : 실무 부서장 기술 인터뷰 ② 임원 면접 : 미국 현지 인터뷰 * '23년 별도 안내 예정

관련 문의사항은 LG이노텍 인재확보팀 안재형 선임으로 연락 바랍니다.

02-6987-2363 ahnjaehyung@lginnotek.com ID : ahnjepal

linktr.ee/2022innotek

LG이노텍

모집 분야 (모듈부품)

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
모듈 부품	광학	**광학 선행 기술 개발** ▪ 카메라, AR, VR 등 광학 시스템 설계 ▪ 굴절/회절 광학 Lens 설계 ▪ Wave Optics, Laser Optics, Planar Optics 설계 ▪ Mobile Camera Actuator 구조/회로 설계 및 제어 기술 개발 **LiDAR Optic System 설계 및 제작** ▪ Tx/Rx 모듈 설계/검증 ▪ Laser Optics 설계/Simulation, SPAD 광학 모듈 설계/Simulation ▪ Lidar System Calibration/Validation	물리 광학 전기 전자 기계 및 관련 전공	서울
	Lens	**Mobile Camera Module, 3D Sensing Module 선행기술 개발** ▪ 응용 광학 선행 기술 개발 ▪ Fourier optics, LASER physic ▪ Spatial Light Modulator **렌즈 개발** ▪ 모바일 및 차량 렌즈 설계/ 개발(광학 설계) ▪ 렌즈 AR 코팅(Recipe/코팅방법/측정/분석 등) ▪ 비전 검사 광학계 설계/ 개발 ▪ 모바일 및 차량 카메라 모듈 광학 업무(공정 설계/ 분석), 선행기술 개발 ▪ CAE 분석을 통한 유동 해석/ 플라스틱 사출 금형 설계		안산
	Actuator	**모바일 엑츄에이터** ▪ Actuator 설계 (기구, 전자계설계) ▪ Actuator 구동 PID 제어기술 (Firmware 설계/검토) ▪ Tribology 관점에서의 Ball actuator 성능 평가 및 개선디자인 도출 **Tribology 분야(마찰/마모)** ▪ Tribology (마찰, 마모, 윤활) 관련 디자인 최적화 진행 ▪ Tribology 관점에서의 Ball Actuator 성능 평가 및 개선 디자인 도출		
	모바일 CM/3D (H/W)	▪ **Mobile Camera Module, 3D Sensing Module 기구, 회로, 광학 설계/평가/분석** ▪ **Mobile Camera Module 적용 Actuator/렌즈 설계/개발** ▪ **Camera 화질 개선 Algorithm 개발, 설비 자동화 SW 개발** ▪ **Camera / 3D Sensing Module 장비 개발**		

모집 분야 (모듈부품)

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
모듈 부품	Radar	**Radar RF 회로/안테나 설계** ▪ mmWave Transmission line 최적화 설계 ▪ 안테나 coupling 구조 설계/ RF 특성 평가 및 Field Test ▪ 77GHz 대역 Array/ Waveguide 안테나 구조 설계 ▪ Passive/Active 방사 성능 평가, 실차 Field Test **Radar Baseband 회로 설계** ▪ 차량용 Radar 전원회로 설계 ▪ 차량 Interface 설계 및 평가(CAN, Ethernet 등) ▪ Digital 회로 설계 및 평가 **Radar 평가 기술 및 Calibration** ▪ 차량용 Radar 평가 환경 구축 및 평가 ▪ Calibration 최적화 및 공정환경 구축 ▪ 실차 Field Test 환경 최적화	물리 광학 전기 전자 기계 및 관련 전공	서울
	전력 전자	**전력변환장치 H/W 개발** ▪ AC-DC / DC-DC / DC-AC / AC-AC 컨버터 ▪ Totem-pole, PSFB, DAB, LLC, Multi-level Topology **제어회로 및 알고리즘 개발** ▪ MCU/DSP 회로 설계 및 센싱/보호회로 설계 ▪ WBG/고주파수 스위칭 구동 회로 설계 ▪ 제어 알고리즘 개발 ▪ FPGA, ASIC 설계		
	Substrate	**반도체 Package용 Substrate 개발** ▪ 주요 제품 개발 (FC-BGA, FCCSP, RF-SiP, 5G용 AP 모듈, AiP 기판 등) ▪ 핵심 기술개발, 재료개발 : Fine Pattern, Small via, ETS/SAP/mSAP, 노광기술, 도금기술, 표면처리기술, 원소재 개발/최적화/신뢰성 확보, 층간 정합 정밀도 제어(Alignment), 검사기술, Warpage Simulation, 방열 Simulation 등 ▪ 제품 불량 분석/개선 활동, 고객 기술미팅 대응 등 **반도체 Package용 Substrate 생산/공정기술** ▪ 수율개선, 품질개선, Capa. 확보, 원가개선 등 생산경쟁력 강화 ▪ 설비투자, 설비 Set-up, 설비자동화/스마트팩토리/DX ▪ 핵심 공법/기술 최적화 : 원자재 가공(ABF 소재), 적층, 드릴/가공(Mechanical Drill/Laser Drill), 도금(디스미어/화학동/전기동), 회로(노광/현상/에칭), S/R(노광/현상/경화), 표면처리(OSP/SMT/SoP/금도금), Back-end공정(마이크로볼/Unit가공/검사)	화학 화공 신소재 고분자 전기 전자 및 관련 전공	구미

모집 분야 (소자소재)

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
소자 소재	자성소재 / 부품	**자성소재 개발** ▪ 연자성 페라이트 및 소재 개발 ▪ 초고주파 자성 소재 개발 ▪ 소재 물성 계산 및 Material Informatics 기법 개발/응용 **자성부품 개발** ▪ RF 소자 및 부품 설계 ▪ 전자기 구조 설계 및 해석 ▪ 트랜스포머/인덕터/필터/액추에이터 자성소재 적용	자성 신소재 세라믹 화학 물리 및 기타 전공	서울
	수동소자 / 부품	**세라믹 신소재 기술/제품 개발** ▪ 세라믹 소재 조성 제어 ▪ 신소재 조성 및 공법 개발 **수동소자/부품 설계** ▪ LC용 수동소자/부품 설계 및 성능 평가 ▪ 칩 캐패시터 구조 설계 및 제조 공법/공정 설계		

모집 분야 (AI/Software)

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
SW	모바일 CM/3D (S/W)	▪ **Mobile Camera Module 검사 / 카메라 Calibration/ 카메라 제어** ▪ **ISP 튜닝 및 평가 / Phone Application 알고리즘 개발** ▪ **카메라 시스템 / 광학 특성 이해를 통한 검사 공정 개발**	컴퓨터 전기 전자 통신 및 관련 전공	안산
	차량용 Embedded S/W	▪ **AUTOSAR BSW Configuration / ASW Development** ▪ **Cybersecurity / HSM Firmware**		서울
	Power Control	▪ **Power Conversion Algorithm** ▪ **Energy Storage System Algorithm** ▪ **Electric Charging / Communication Algorithm**		
	Cellular / V2X	▪ **4G/5G Network Protocol** ▪ **V2X (C-V2X, DSRC) Protocol & ITS Stack algorithm**		
	모터제어 SW	**모터제어 Software 개발** ▪ 모터 제어 알고리즘 개발 및 테스트(토크 제어, 전류 제어, 속도 제어, 센서리스) ▪ 센서 처리 알고리즘 개발 및 테스트(위치센서, 전류 센서, 압력센서, 온도센서) ▪ 고장진단 구현 및 테스트 **차량용 Embedded Software 개발** ▪ MCU Firmware 개발 ▪ IC용 Driver SW 개발 ▪ ISO14229 기반 진단 SW 개발 ▪ SW Architecture 설계 및 API 개발		
	SW 플랫폼	**AUTOSAR Software 개발** ▪ AUTOSAR BSW Modules 개발 ▪ 차량 네트워크/프로토콜 개발 ▪ 차량 표준 프로세스 대응 및 Cyber Security / Functional Safety 개발 **Non AUTOSAR 플랫폼 개발 및 SW 프로세스** ▪ SW 요구사항 분석/설계/구현 ▪ SW 인터페이스 및 구조 설계/최적화 ▪ SW 개발 프로세스 수립 및 SW 플랫폼 기반 품질 테스트/평가		
	AI / Big Data	**AI Software 개발** ▪ 소재/부품 분야 AI 기반 알고리즘 및 응용 소프트웨어 개발 ▪ 제조/공정/설비 데이터 기반 머신러닝/딥러닝 알고리즘 개발 ▪ 시계열 데이터 분석/예측을 위한 AI 기술 및 응용 시스템 개발 ▪ 자연어 및 이미지/영상 기반 AI 기술 및 응용 시스템 개발 ▪ 데이터처리 자동화/정보화 기술 개발 ▪ 최적화, 이상 감지, 비전 검사, 물성 예측(Material Informatics) AI 솔루션 개발 **AI 플랫폼 개발** ▪ AI 모델 활용을 위한 MLOps 플랫폼 기획/설계/구축 ▪ 데이터 전처리, 모델 학습, 배포 파이프라인 구축/운영 ▪ AI 모델 학습 자동화 시스템 구축 ▪ AI 모델 재학습 알고리즘 개발		

모집 분야 (기타)

모집분야		세부 내용	유관전공	근무지
기타	Simulation	**구조, 열/유동, EMI/EMC Simulation** ▪ 선행/양산개발 제품 설계 Simulation 및 제조/생산 공정 Simulation ▪ 기판 공정 열/기계 응력 및 Package Warpage 거동 예측, 박막 변형 예측 ▪ EMI/EMC Simulation (System Level CE/RE 시험평가 예측, EMS/ESD 시험평가 예측)	기계 전기 전자 및 관련 전공	서울
	기구	**기구설계 플랫폼 구축 및 선행 기구 개발** ▪ 기구 구조 및 제품 설계 ▪ 기구 소재 개발(Engineering Plastic, Metal, Glass) ▪ 기구 요소기술 개발(금형/방수/방진/방열/차폐/표면처리) ▪ 설계 자동화/표준화	기계 자동차 재료 신소재 및 관련 전공	